

ARQUITECTURA Y FABRICACIÓN

- Arquitectura: Basado en microarquitecturas como Skylake, Cascade Lake, Ice Lake,
- Proceso de fabricación: 14nm, 10nm o más avanzado (dependiendo del modelo).



- Múltiples núcleos y hilos: Soporta hasta 40 núcleos y 80 hilos en modelos avanzados.
- Hyper-Threading: Tecnología que permite que cada núcleo ejecute dos hilos simultáneamente.
- Rendimiento optimizado para multitarea: Ideal para servidores y estaciones de trabajo.







- Memoria DDR4/DDR5: Soporte para grandes capacidades y alta velocidad de memoria.
- Soporte para memoria ECC: (Error Correcting Code) para evitar errores de memoria y aumentar la estabilidad.
- Soporte para memoria Intel Optane: Mejora el rendimiento y la capacidad de almacenamier

XEON PROCESSOR

PROCESADOR PARA **SERVIDOR**



- Soporte para PCle 3.0 y 4.0: Ancho de banda alto para tarjetas gráficas y otros dispositivos.
- Soporte para Ethernet y Thunderbolt: Conectividad avanzada para servidores y estaciones de trabajo.



FIABILIDAD, SEGURIDAD Y **GESTIÓN**

- Intel vPro: Características de gestión remota y seguridad para entornos empresariales.
- Intel Trusted Execution Technology (TXT): Protege contra amenazas de software malicioso.
- Tecnología de virtualización Intel VT-x y VT-d: Meior rendimiento paramáquinas virtuales.



- MERCADO DE APLICACIÓN Estaciones de trabajo: Computación de alto rendimiento, diseño gráfico, simulaciones.
- Servidores: Ideal para centros de datos y servidores empresariales de misión crítica Clústeres de alto rendimiento (HPC): Procesamiento paralelo en investigaciones científicas y financieras.



